

中信证券股份有限公司
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
2025 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”或“上市公司”）公开发行人转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了半年度募集资金现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 10 日对公司进行了募集资金现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、《烟台睿创微纳技

术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，对大额募集资金使用进行抽凭核查；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术与产品研发风险

公司是研发驱动型公司，过去多年专注于红外成像领域的技术研发和产品设计，近年来公司实现经营业绩大幅增长。未来公司将持续沿着红外、微波、激光等多维感知方向进行研发投入。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致盈利降低甚至造成亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

2、核心技术人员流失风险

公司坚持技术队伍建设和培养，目前已经形成以马宏为首的核心技术团队，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。如果发生现有核心技术人员流失，可能对公司的盈利能力产生不利影响。

（二）经营风险

1、部分重要原材料及委托加工服务采购集中度较高的风险

由于公司对于产品加工工艺的精密度、产品性能的稳定性方面等有较为严苛的要求，同时由于晶圆加工等上游行业集中程度较高，因此在晶圆、晶圆加工服务等重要原材料的采购过程中，公司选择单一或少量供应商进行合作，采购集中度较高。如果主要供应商的生产经营出现较大困难，产品质量下降或产能紧张无法满足公司需求，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

2、产品质量风险

公司的主要产品为红外探测器芯片、热成像机芯模组、红外热像仪整机、激光微波产品及光电系统等，公司提供的产品具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点，产品研发、制造等技术具有较高的复杂性。如果公司在产品研制过程中出现质量未达标准的情况，将对公司的品牌形象造成不利的影响，导致客户流失，进而对公司盈利能力产生不利影响。

3、产品未完成定价议价而影响经营业绩的风险

报告期内，公司部分特种装备产品的价格采取定价议价方式确定，对于定价议价尚未完成但已实际验收交付的产品，公司在符合收入确认条件时按照暂定价确认收入，待价格确定后签订补价协议或取得补价通知单时确认价格差异。由于定价议价周期和最终审定价格均存在不确定性，受此影响，尚未定价议价产品存在未来年度集中确认价差进而对公司盈利构成影响的风险。因此，公司存在因产品未完成定价议价而影响经营业绩的风险。

（三）财务风险

1、主营业务毛利率下降的风险

报告期内，公司实现主营业务毛利率 51.34%。未来，随着同行业企业数量的增加、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，整体利润率水平可能产生波动，进而对公司的主营业务毛利率造成不利影响。另外，若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化，可能导致公司产品单价和成本的波动，则公司将面临主营业务毛利率下降的风险。

2、应收账款无法回收的风险

截止 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款账面金额为 145,242.39 万元，较期初增长 13,469.61 万元，增幅 10.22%。公司应收款项的客户主要是特种装备客户或者是有行业影响力且信誉较高的大客户，并且根据历史回款情况看，从历史经验看相关应收账款回收良好。

应收账款的快速增长对公司现金流状况产生了影响，增加了公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

3、存货跌价的风险

截止 2025 年 6 月 30 日，公司存货账面金额为 196,235.45 万元，较期初增长 12.47%。公司根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划，存货规模随着业务规模增长而快速增加。虽然公司建立了较完善的存货管理体系，合理控制存货，并计提了存货跌价准备，但如果原材料价格或市场环境发生变化，公司将面临存货跌价等风险。

（四）行业风险

1、产业起步较晚，部分民用市场尚未成熟

我国红外热成像产业起步较晚，部分市场应用相对落后于欧美发达国家，尚有巨大的市场培育和成长空间。目前，我国红外热像仪应用最成熟的民用市场主要是电力检测、安防监控，其它如工业测温、人体测温、消费电子等领域发展迅速，汽车辅助驾驶领域前景广阔，但总体应用不够成熟。从行业发展趋势来看，随着红外热像仪成本和价格的进一步降低，红外成像技术将在越来越多的领域中得到应用。但我国民用市场能否有效培育和成长存在一定的不确定性。

2、特种装备业务向民营资本开放相关政策变化的风险

自 2007 年以来，中国国防科学技术工业委员会及国务院先后下发多个文件对民营企业参与国防科技工业放宽市场准入、支持非国有企业参与武器装备科研

生产等作出规定。作为民营企业，公司抓住了特种装备市场迅速发展的机遇，特种装备类红外产品研制业务逐步扩张，若国家对特种装备业务向民营资本开放的相关政策发生变化，将可能对公司特种装备业务造成不利影响。

（五）宏观环境风险

1、贸易环境变化风险

公司出口产品主要销往欧洲和北美等地区，若未来我国与公司主要的产品出口国贸易关系恶化，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的贸易环境变化风险。

2、汇率波动风险

由于公司出口产品的主要结算货币为美元，因此人民币对美元的汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的外汇风险。

3、税收优惠政策变化的风险

集团内公司有享受国家鼓励的重点集成电路企业、高新技术企业相应的企业所得税优惠政策。如果未来国家或地方对税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企业认定，则无法继续享受有关所得税税收优惠政策，继而对公司的利润水平造成一定负面影响。

4、政府补贴降低的风险

报告期内，公司计入损益的政府补助为 1,226.08 万元。作为国家扶持的战略性新兴产业，公司先后参与国家级、省部级多个研发项目。项目将在完成验收后分期转入营业外收入和其他收益，从而增厚公司未来各期利润。国家政策的变化和产业导向将对相关产业投资产生重大影响，随着相关产业领域的发展成熟，公司未来获得的政府补贴可能会逐步减少，从而会对公司的利润规模产生一定的不利影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司

存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	254,379.36	202,170.93	25.82
归属于上市公司股东的净利润	35,101.15	22,433.87	56.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,840.68	20,789.95	57.96
经营活动产生的现金流量净额	31,838.87	7,431.08	328.46
主要会计数据	2025 年 6 月末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	576,128.21	540,433.90	6.60
总资产	934,388.31	880,619.67	6.11
主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.77	0.50	54.00
稀释每股收益（元 / 股）	0.76	0.49	55.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.72	0.46	56.71
加权平均净资产收益率（%）	6.27	4.65	增加1.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.87	4.31	增加1.56个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.96	18.34	增加1.62个百分点

营业收入同比增长 25.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 56.46%，基本每股收益同比增加 54.00%，主要原因是公司持续进行研发投入和新产品开发，加强开拓市场，扩大销售，实现收入增长，带来净利润和每股收益增长。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、人才和激励优势

公司已形成一支高素质的研发团队，主要研发人员均为硕士及以上学历，技术领域包括半导体集成电路、MEMS 传感器、图像处理算法等，全面覆盖了公司技术和产品各个环节。截至报告期末，公司拥有研发人员 1738 人，占公司员工总数的 51.54%，研发团队稳定性强，核心技术团队自公司设立之初不断扩充优秀人才，长期从事光电技术和产品的研发、工程及量产制造，具有丰富的行业经验。公司围绕中长期发展战略和人力资源策略，持续构建和完善人才、激励、文化为核心的人力资源体系。建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的积极性和公司的发展活力。

2、技术和研发优势

公司是研发驱动型企业，在非制冷红外成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。公司已掌握集成电路设计、MEMS 传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。公司成功研发出世界第一款像元间距 $8\mu\text{m}$ 、面阵规模 1920×1080 的大面阵非制冷红外探测器，第一款 $6\mu\text{m}640\times 512$ 非制冷红外探测器，提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外图像开源平台，夯实了公司在非制冷红外领域国内领先，国际先进的技术地位。截至报告期末，公司累计申请知识产权 3,468 个，已获批 2,170 个。公司于 2020 年获批作为牵头单位承担“电子元器件领域工程研制”国家科技重大专项研发任务，课题类型为非制冷红外科研领域高灵敏度技术方向；于 2022 年中标发改委某射频芯片项目，助力国家卫星通信产业发展。公司自 2009 年起进入非制冷红外焦平面芯片领域，已经培养了一批经验丰富的技术人员，并具备了规模化生产的丰富经验，对非制冷红外焦平面芯片的应用环境也更加了解，具备一定的技术先发优势。公司在微波领域已建立完整产业链，以 T/R 组件、相控阵子系统及雷达整机切入微波领域，同时在底层的微波半导体方面持续建设核心竞争力。

3、全系列产品量产优势

公司具有红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品研制与批量生产经验，目前已经成功研发并批量生产 256×192 面阵、 384×288 面阵、 640×512 面阵、 1024×768 面阵及 1280×1024 面阵，像元尺寸为 $35 \mu\text{m}$ 、 $25 \mu\text{m}$ 、 $20 \mu\text{m}$ 、 $17 \mu\text{m}$ 、 $14 \mu\text{m}$ 、 $12 \mu\text{m}$ 、 $10 \mu\text{m}$ 和 $8 \mu\text{m}$ 的非制冷红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品。成功研发并实现批量生产一系列红外探测器和机芯模组产品，面向工业领域、视觉感知与探测领域、汽车领域、户外领域等多系列多款红外热像仪整机产品，新一代智能手机红外热像仪等消费类产品，系列用于手持观瞄、车载光电系统等红外热像仪整机产品。T/R 组件持续稳定批量交付。

4、平台优势

公司建有读出电路设计、焦平面阵列设计、封装与可靠性设计平台，具备组件全流程设计能力，已实现 $35 \mu\text{m}$ 至 $6 \mu\text{m}$ 像元间距、 1920×1080 至 256×192 面阵规模系列化产品的全流程设计。焦平面阵列制造技术平台线宽从 $0.18 \mu\text{m}$ 提升至 $0.13 \mu\text{m}$ 。红外探测器制造平台加速自动化部署，年产能已达 600 万只；晶圆级热成像制造平台完成迭代，通过加大自动化设备投入，自动化率提升 60%，年产能增至 500 万只；热像仪整机年产能提升至 100 万只。公司拥有完整的全性能测试平台，能覆盖 1920×1080 至 256×192 阵列规模非制冷红外焦平面组件全性能测试。此外，随着各个领域对红外成像产品的可靠性要求日益严格，可靠性保障平台成为红外成像产品技术平台的重要组成部分。公司建有完整的可靠性设计、筛选和检验保障平台，并通过了 CNAS 国家认可实验室认证，保证了公司各系列红外产品能够进行全面的可靠性筛选。依托于公司的技术平台，公司产品能够保证迭代速度和技术优势。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	50,784.56	37,082.69	36.95
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	50,784.56	37,082.69	36.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.96	18.34	增加1.62个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内，公司研发投入较去年同期显著增长，主要系为加速推进核心项目研发、提升技术创新能力，公司积极引进高端研发人才，人员费用增加；同时为保障研发需求，物料采购投入也相应加大。

（二）研发进展

公司继续坚持客户需求先导，技术创新领先，加大研发投入，持续推动在红外、微波、激光领域的布局。

非制冷红外器件方面，报告期内持续优化 6 μm 产品，完成了 8 μm 系列产品量产，1920 $\times$ 1080、1280 $\times$ 1024 及 640 $\times$ 512 面阵三款产品已进入量产阶段，可批量化供应，完成第二代 8 μm 200 万像素探测器产品的样品开发，相比第一代产品尺寸、重量大幅减小，性能提升。优化 10 μm 系列产品，推动 640 $\times$ 512 面阵陶瓷封装产品的量产和差异化应用，开启 10 μm 产品小型化封装研发。优化提升 12 μm 系列产品，推动 1280 $\times$ 1024 面阵产品性能提升，满足客户复杂场景、高端应用的需求；加速 640 $\times$ 512 面阵高性能产品的量产，提升产品竞争力；完成 12 μm 640 $\times$ 512 面阵高帧频、小型化陶瓷封装探测器开发，扩大探测器的核心竞争优势；完成 12 μm 384 $\times$ 288 面阵 SWLP 产品的开发和小批量生产，推动探测器产品的小型化和成本降低，提升器件的易用性和可靠性，面向批量化、全加工环境场景，全行业应用场景；持续优化晶圆级封装技术，满足车载、工业等民用市场对热成像探测器的小型化、低成本的需求；布局开发新一代传感器和封装技术，进一步提升图像性能，压缩成本，缩小探测器体积，满足未来户外夜视、消费电子、低空经济等领域的应用需求；探索开发新型材料及真空封装技术，为红外热成像在其他更广泛的领域应用做好技术储备。

光子器件方面，持续推进多款 InGaAs 探测器的批产验证；研制了面向卫星通信的 $10\ \mu\text{m}400\times400\text{InGaAs}$ 探测器和面向光电吊舱的 $10\ \mu\text{m}1280\times1024\text{InGaAs}$ 探测器，正在进行下一代产品研制与技术攻关。公司系列化 InGaAs 探测器及机芯已经应用于天文望远镜、卫星通信、地面空间通信、机器视觉、光伏检测、食品分选、光谱分析、生物医学成像等领域。成功开发了 $30\ \mu\text{m}320\times256$ 高温中波超晶格气体成像探测器， $15\ \mu\text{m}640\times512$ 长波超晶格探测器及机芯、 $15\ \mu\text{m}640\times512$ 高温中波超晶格探测器及机芯已经交付客户。超晶格探测器在高端装备、科研仪器、气体探测等领域具有广阔的应用前景。

报告期内，公司继续深耕 AI 在各业务领域的应用，从芯片设计到终端产品取得多项重要进展。第三代红外图像处理 SOC 芯片架构持续迭代优化，AI-ISP 底层架构设计达国际先进水准；进一步完善红外图像专用的 NPU 架构设计，迭代升级车载感知算法、精细化渲染算法，为车载客户提供更多功能亮点；完成近内存计算的计算单元原型设计，通过 CIM（Compute in Memory）技术，进一步降低芯片功耗，提高整体性能。红外/可见光双光谱通用人车目标检测识别跟踪算法持续提升；推出行业首个红外热成像、可见光与 4D 毫米波雷达的智能融合算法与产品。深耕视觉多光谱探测与感知领域，在短波红外、中波红外、长波红外及微波雷达产品的软硬件研发中，持续融入 AI 技术——通过迭代智能探测、识别等核心算法，不断提升技术精度。同时聚焦低空弱小目标探测赛道，依托低空场景的深度研究与落地应用，推进低空安全监测样板点建设，实现多维感知探测与 AI 技术的深度耦合，为低空经济安全高效运行夯实技术底座。个人消费领域，重点深化红外图像算法与 SOC 主控平台研发，成功落地自动标注、图像生成等 AI 应用；持续推进技术探索，第二代 AI 图像增强技术及系统架构技术成功落地应用，巩固了产品技术领先优势。机器人领域，公司从智能感知、智能多模态分析与决策、以及智能操作执行等算法与软硬件产品、系统等多个方面投入研发资源，不断进行技术与产品升维。

车载领域，公司持续完善多维感知+AI 布局。车载红外热成像产品体系实现全分辨率覆盖与车规认证升级，产品形态包含单红外、双光融合等类型，分辨率实现 256×192 、 384×288 、 640×512 、 1280×1024 及 1920×1080 全覆盖；在 2023 年发布国内首款通过 AEC-Q100Grade2 车规级认证的 $12\mu\text{m}$ 像元间距红外热

成像探测器的基础上，2024 上半年公司 8um 热成像芯片和 ISP 专用芯片又陆续通过 AEC-Q100 Grade2 车规级认证，更广泛的满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。同时公司自研的车载行业 AI 算法方面进行一系列升级，新增交付形态从单模组扩展到解决方案。报告期内，微波业务也加快了面向车载应用的产品布局，公司完成第一代车载 4D 毫米波雷达射频芯片 FA77 的研制与验证，FA77 采用先进 CMOS 制程及 FMCW 体制，支持多芯片同步级联；完成第一代车载 4D 毫米波成像雷达产品 RA223F 的研制与验证，基于多级联射频芯片及自研波形与算法 RA223F 实现了高分辨率、高数据率及密集点云的毫米波成像，并具备强目标分类识别能力，第二代 4D 毫米波成像雷达产品 RA225F 启动研发。

报告期内，微波业务继续推进从核心芯片到组件、子系统、分系统、整机的全链条技术和产品研制，各业务模块均取得了显著进展，各业务模块协同效应显现。化合物半导体方面，继续扩展产品线，丰富了 GaAs MMIC、GaN MMIC、GaN 射频功率器件、射频前端集成电路（RF FEM）的货架产品系列与定制产品系列，持续稳定交付，获得某头部客户合格供应商认证。硅基毫米波集成电路方面，完成某部委卫星互联网宽带终端中频芯片的项目验收，完成客户评测及与基带芯片的联合调试，并与基带芯片合作伙伴协同进行卫星互联网宽带终端基带模组研制；某头部客户的宽带收发机定制芯片完成第二轮流片验证，核心功能均得到收敛验证，正在与客户进行场景验证；模拟波束赋形芯片完成国产先进半导体工艺的首轮流片验证，取得良好进展。射频微系统方面，完成第二代高密度先进 SiP 技术攻关，基于自研 MMIC 芯片与硅基模拟波束赋形芯片推出 X 波段 20W DS-SiP 原型产品，在保障产品性能与可靠性的同时，大幅提升 SiP 产品的 SWaP-C 指标，获得头部客户认可，正在进行联合工程验证。微波组件方面，某研究院线阵组件研制项目进展顺利，持续交付；高可靠性宇航级组件代工生产持续稳定交付。微波子系统及整机方面，推进针对低空飞行器的探测、监管与反制技术及产品的研发，在射频探测、主动探测、频谱侦测、干扰压制等方面取得进展，多款产品完成研制。在卫通互联网方面，基于自研核心芯片及先进相控阵天线技术，开展 Ku 及 Ka 频段低轨卫通相控阵终端产品研制，完成多款有源相控阵天线原型机的测试验证，与合作伙伴联合开展 K/Ka 频段卫通相控阵终端地面测试，取

得关键进展。在最新一轮整机终端集成测试中，系统成功实现卫星连通，并顺利完成基础业务验证。测试中，依托我方先进相控阵天线系统，在真实卫星链路环境下，流畅支持手机端多项典型应用，包括短视频播放与高清视频通话等；这一成果初步验证了自研卫星通信芯片与相控阵天线在实际场景下的性能与稳定性、可靠性。

激光方向，激光测距产品线布局铟玻璃激光器、铟玻璃测距模组、半导体测距模组，具备人眼安全、体积小、重量轻、功耗低、精度高、可靠性好等特点，持续推进研发和批量生产。铟玻璃激光器能量覆盖 100 μ J-1mJ，测距模组最大测程覆盖 1~20km，产品广泛用于民用无人机、光电吊舱转台、边海防、户外手持观测等多个领域。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金实际使用进度与披露情况基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管

理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押/冻结总数
马宏	董事长、核心技术人员	69,500,000	69,500,000	0	/	0
李维诚	董事	42,470,130	42,470,130	0	/	0
赵芳彦	董事、副董事长、副总经理	3,075,000	3,075,000	0	/	0
王宏臣	董事、轮值总经理、副总经理	1,569,906	1,569,906	0	/	0
张力上	独立董事	0	0	0	/	0
余洪斌	独立董事	0	0	0	/	0
梅亮	独立董事	0	0	0	/	0
魏慧娟	职工监事	242,747	242,747	0	/	0
孙瑞山	监事	371,039	371,039	0	/	0
刘岩	监事会主席	0	0	0	/	0
黄艳	董事会秘书	15,000	30,000	15,000	限制性股票激励计划归属导致	0
高飞	财务总监	0	9,375	9,375	限制性股票激励计划归属导致	0
陈文礼	副总经理	1,805,000	1,830,000	25,000	限制性股票激励计划归属导致	0
江斌 (离任)	副总经理	3,011,312	3,011,312	0	/	0
陈高鹏	副总经理、核心技术人员	62,500	125,000	62,500	限制性股票激励计划归属导致	0
董珊	核心技术人员	2,800	2,800	0	/	0

公司董事长马宏通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）分别间接持有公司股票 659,221 股、233,766 股，本报告期间接持股数未发生增减变动；公司副总经理江斌（离任）通过烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 60,430 股，本报告期间接持股数未发生增减变动。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
2025 半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

刘芮辰

刘芮辰

安楠

安楠

